

Applied Materials Launches Three Advanced Packaging Technologies and Announces a Joint Development Agreement with EVG - September 13, 2021

應材推3項先進封裝技術 攜EVG簽聯合開發協議

2021-09-13 12:56 經濟日報 / 記者尹慧中 / 即時報導

+ 面板

分享



應用材料公司今（13）日發布新技術與能力，幫助客戶加速實現異質晶片設計與整合的技術藍圖，推出3項先進封裝相關技術，並與益高科技(EVG, EV Group)簽訂聯合開發協議，協同最佳化晶圓對晶圓混合鍵合(Hybrid Bonding)解決方案。

依據應用材料公司先進封裝研發中心說明，為裸晶對晶圓的混合鍵合開發出新的先進軟體模型與模擬技術，縮短客戶產品上市時間。

另外應材指出，透過近期收購的面板級製程領導廠商 Tango Systems，為先進封裝技術提供更大型且更高品質的基板。

此外，應材旗下顯示器業務為客戶提供大面積良率管理的解決方案與其他技術。

由於晶片製造商不斷在精密的2.5D與3D封裝設計中植入更多晶片，使得更先進基板的需求與日俱增。應用材料公司運用最近收購的Tango Systems提供的先進面板製程技術，來增加封裝尺寸與互連密度。相較於晶圓尺寸的基板，500 mm²以上的面板尺寸基板能夠封裝更多晶片，進而提升晶片的成本效益、功率與效能。

隨著客戶開始採用這些較大面板尺寸的基板，應用材料公司旗下的顯示器事業群也提供大面積的材料工程技術，包括沉積、電子束測試(eBeam testing; EBT)、掃描式電子顯微鏡(SEM)檢測與量測，以及針對缺陷分析的聚焦離子束(FIB)。

應用材料公司表示，結合其領先業界的先進封裝與大面積基板技術，與產業合作夥伴攜手開發新解決方案，大幅改善晶片功率、效能、單位面積成本與上市時間(PPACT)。

晶片

晶圓

面板

<https://udn.com/news/story/7240/5742388>